

2015年5月19日
三菱電機株式会社

NEWS RELEASE

GTF2 シリーズをモデルチェンジし、高い生産性を実現
三菱電機基板穴あけ用レーザー加工機「GTF3 シリーズ」発売のお知らせ

三菱電機株式会社は、基板穴あけ用レーザー加工機の新製品として、新開発の高精度ガルバノスキャナーと半導体パッケージ基板加工に優れたレーザー発振器の搭載により、高い生産性と加工位置精度を実現した「GTF3 シリーズ」を5月22日に発売します。

本製品は、「JPCA Show 2015（第45回国際電子回路産業展）」（6月3日～5日、於：東京ビッグサイト）に出展します。



三菱基板穴あけ用レーザー加工機「ML605GTF3-5350UM」

新製品の特長

1. 新開発のガルバノスキャナーと半導体パッケージ基板加工に優れたレーザー発振器の搭載により、高い生産性を実現

- ・新開発のガルバノスキャナー^{※1}と半導体パッケージ基板加工に優れたレーザー発振器「5350UM」の搭載により、加工時間を約30%短縮^{※2}し、高い生産性を実現

※1 ミラーを高速で駆動し、レーザー光を位置決めする装置

※2 従来機 GTF2 シリーズとの比較（加工時間は加工内容によって異なります）

2. 加工機の高剛性化とガルバノスキャナーの高精度化により、高い加工位置精度を実現

- ・加工機の内部構造見直しによる高剛性化と新開発の高精度ガルバノスキャナーの搭載により、加工位置精度を約10%改善^{※3}

※3 従来機 GTF2 シリーズとの比較（加工位置精度は加工内容、加工材料によって異なります）

発売の概要

製品名	形名	希望小売価格 ^{※4} (税抜き)	発売日	生産台数
基板穴あけ用 レーザー加工機	ML605GTF3-5350UM	1億5900万円	5月22日	年間50台

※4 標準仕様の場合（搭載オプションによって異なります）

発売の狙い

スマートフォンやタブレットPCといったデジタル機器のさらなる高機能化と小型化が進む中、小型デジタル機器用の半導体パッケージ基板の製造においては、基板への微細穴あけ用途としてレーザー加工の需要が拡大しています。一方、レーザー加工機に対しては、基板製造工程のコストダウンを図るためにさらなる加工時間の短縮、および半導体パッケージ基板の小型高性能化の実現に向け、高い加工位置精度が求められています。

これらの要求に応えるために、当社は今回、新開発の高精度ガルバノスキャナーと半導体パッケージ基板加工専用のレーザー発振器の搭載により、高い生産性と加工位置精度を実現した基板穴あけ用レーザー加工機「GTF3シリーズ」を発売します。

主な仕様

項目		仕様	
システム	形名	ML605GTF3-5350UM	
	外形寸法 (mm) ^{※5}	4620W×3370D×2270H	
	機器質量 (kg) ^{※5}	9000	
加工機	XY テーブル	加工ワーク寸法 (mm)	620×560
		最大送り速度 (m/min)	50
発振器	レーザーの種類	CO ₂ レーザー	
	出力 (W)	210	
	設定周波数 (Hz)	10～10000	

※5 加工機・発振器・制御装置・冷却装置・ワーク吸着装置・基板搬送装置(オプション)を含めた寸法・質量
基板搬送装置の仕様によって寸法・質量は異なります

製品担当

三菱電機株式会社 名古屋製作所
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目1番14号
TEL 052-712-2209 FAX 052-712-3483

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
TEL 03-3218-6540 FAX 03-3218-6822